

SMT Single Pair Ethernet Steckverbinder, stehend, Einbau in Verbindung mit 661-4

SMT Single Pair Ethernet Connector, vertical, for assembly with 661-4

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing vernickelt, Gummi, Mutter: Edelstahl
Shell	Nickel plated brass, Rubber, Nut: Stainless steel
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold plated over nickel
Oberfläche Lötanschluss	Mattzinn über Nickel
Plating Solder Side	Matte tin plated over nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	Gehäuse: 6c; Mutter: 6a
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	Housing: 6c; Hex Nut: 6a
Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Insulation Resistance	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennspannung	72 V DC
Voltage Rating	72 V DC
Nennstrom	4 A
Current Rating	4 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Temperature Range	-40 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
Data Transfer Ratio: 1 Gbit/s



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

